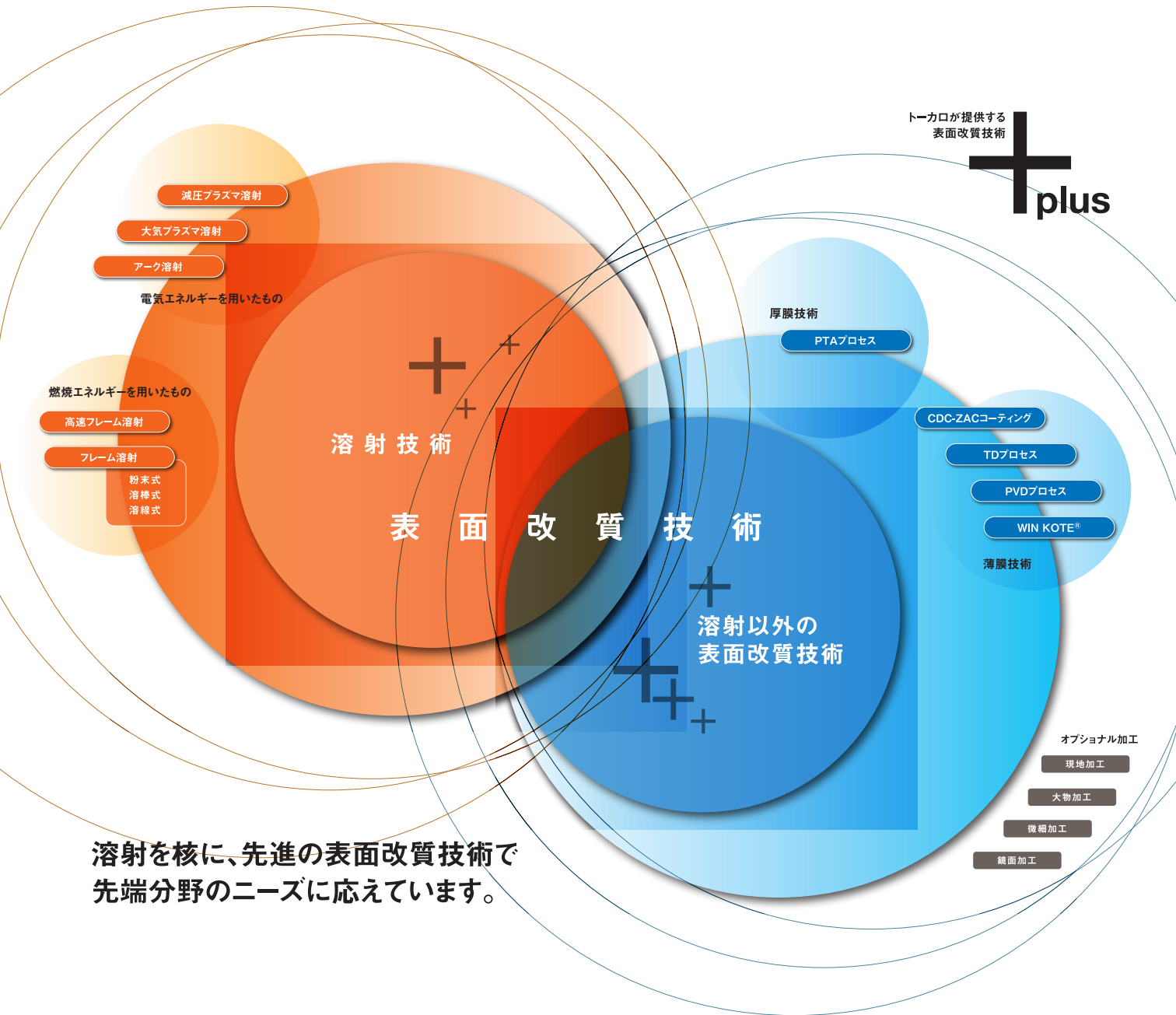


事業年度 基準日	毎年4月1日から翌年3月31日まで 定時株主総会 3月31日
配当金受領株主確定日	期末3月31日 中間9月30日
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	〒541-0044 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話(通話料無料)0120-094-777
公告方法	電子公告 当社ホームページ(http://www.tocalo.co.jp/) に掲載します。
単元株式数	100株

- (ご注意)
- 1.株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
 - 2.特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店でもお取次ぎいたします。
 - 3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行全国本支店でお支払いいたします。





代表取締役社長 町垣 和夫

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は当社に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

長く続いた不景気も漸く底を打った感があり、当社グループを取り巻く経済環境も、少し明るさを取り戻しつつあります。

当期は過去に経験が無い、非常に厳しい経済環境に晒されましたが、営業、製造、技術の各部門が一体となり、受注活動、コスト削減に取り組んだ結果、計画以上の収益を確保することができました。

世界経済は中国が牽引する形で緩やかな回復局面が続き、プラス成長に転じるものと考えられますが、引き続き積極的な市場開拓に取り組むとともに収益体質の強化に努めてまいります。

今後も引き続きのご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

第59期の業績

一昨年の世界規模での急激な景気後退により、当期スタート時は受注数字が景気後退前と比べますと、30%以上減少する事態となり、特に半導体製造装置関連は50%を割り込むところまで落込みました。

この様な環境の中で、当社グループは収益確保のため全社あげてのコスト削減に懸命に取り組みました。具体的には変動費の削減はもとより、固定費につきましても過去に実施経験の無い全社一斉並びに工場・部署毎での休業、役員・管理職の給与カット等を実施いたしました。

その結果、トータル単体で損益分岐点売上高は前期比で月額約2億円の低減を図ることができました。

連結子会社であります日本コーティングセンターは、主要顧客が自動車関連であり、上半期は大幅な受注減少により経常赤字となりましたが、下半期に入ってから徐々に受注環境も改善し、若干の黒字となりました。しかしながら通期では94百万円の経常赤字となりました。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高は予算比3億5千万円減の180億99百万円（前期比19.8%減）、経常利益は予算比5億6百万円増の22億6百万円（前期比18.5%減）となりました。

なお、株主様に対する利益還元につきましては、当期純利益が業績予想を上回りましたので、期末配当を1株当たり17円50銭と、期初の配当計画より1株当たり5円の増配といたしました。これにより年間配当は中間配当と合わせて、1株当たり30円（配当性向35%）といたしました。

第60期の経営目標

景気は、自力回復力が弱いものの、国内における景気対策の延長やアジア地域における需要拡大を受け、しばらくは回復基調をたどると見込まれます。

とりわけ、半導体・液晶業界は、需要が堅調であることから停滞していたIT投資につきましても回復が期待されます。

こうした状況のもと今期も経営理念であります「全天候型経営」を実現すべく、製造・営業・研究開発の三位一体体制による業容の拡大と高収益の確保に取り組んでまいります。

今期の通期連結業績見通しにつきましては、売上高200億円（前期比10.5%増）、経常利益30億円（同36%増）を見込んでおります。

配当につきましては、1株当たり年間40円（予想配当性向34%）とする予定であります。

尚、今期からは中国の子会社であります「東華隆（広州）表面改質技術有限公司」も重要性が増してきたことより連結の範囲に含める予定です。

東華隆（広州）表面改質技術有限公司の業績と今後の戦略

平成17年4月、漢泰科技股份有限公司（中華民国台湾省）との合併で中華人民共和国広東省広州市に設立した東華隆（広州）表面改質技術有限公司は開業後3年が経過し、現在第4期に入っております。

順調に伸びておりました業績も当期はリーマンショックの影響により、受注が減少し27百万円の経常赤字となりました。

しかし直近ではプラントメーカーから製鉄設備に関する複数の大型引合い案件がある他、産業機械関係では収益の柱となりえる定常受注品の獲得に成功しており、受注環境は確実に改善、拡大しております。

そして人材の確保、生産技術の修得をはじめ、経営の体制も整いつつあり、今期は収支的に黒字計画としております。

今後の展望については、一例ではありますが、半導体、液晶関係の国内外の大手企業が中国での投資計画を進めております。今後操業が本格化しますと、現地での装置メンテナンスサービスが必要となり、これは大きなビジネスとなるものと思われます。このようなビジネスにどう取り組むか等、現在の中国には日本では想像もつかないスケールの大きなビジネスチャンスがありますので、積極的且つ慎重に検討を進めビジネスチャンスを掴んでいきたいと考えます。

今後の展望と成長戦略

当社は経営理念の「研究開発主導型企業」として、5年先、10年先も成長が継続できる新しい技術開発、市場開拓を進め、「全天候型企業」の実現に向けて取り組んでいます。

企業が中長期的に持続成長するには、新たなビジネスモデルの構築が必要不可欠であります。当社グループは表面改質技術を用いた新たな価値創造により、未知の分野・業界への参入、商品開発および技術の確立に鋭意取り組み、新たな収益源の確保を目指してまいります。

そして、市場に関しましては国内だけではなく、経済発展が著しい中国を中心とする新興国も視野に入れ、前向きに取り組んでいきたいと考えます。

今後も現状に満足することなく、更なる成長を目指して努力し続け、株主の皆様のご期待に応えるべく、積極的な経営をすすめてまいります。

株主の皆様のご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。



当社は毎年各地で開催される技術展示会に出展しております。ご来場いただければサンプル品、展示パネルやビデオによる技術紹介をさせていただきます。また投資家・株主の皆様からの質問にもお答えできるよう準備をしておりますのでぜひ一度お越しください。

今後の出展予定

平成22年7月7日～9日
「表面改質展2010in名古屋」
会 場：ポートメッセなごや
平成22年10月6日～8日
「第13回関西機械要素技術展」
会 場：インテックス大阪

今後の出展予定は開催日が近付くと当社ホームページでもお知らせしております。

「第1回高機能フィルム技術展」出展風景

平成22年4月14日～16日に東京ビックサイトで開催された同展示会の出展風景です。



平成22年6月7日～9日に中国 上海市で開催された「2010国際表面工程展覧会」に現地子会社の東華隆（広州）表面改質技術有限公司とともに出展しました。

決算発表

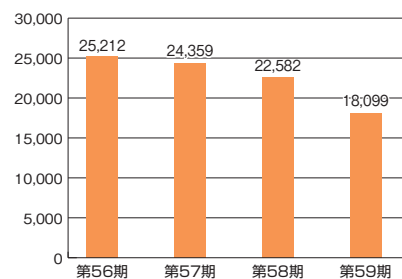
平成22年5月7日	第59期末決算発表	(実施済)
平成22年7月30日	第60期第1四半期決算発表	(予定)
平成22年10月29日	第60期中間期決算発表	(予定)

決算発表予定日は当社ホームページでもお知らせしております。

売上指標

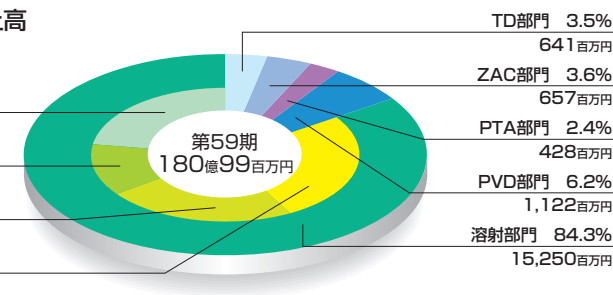
●売上高

(単位:百万円)



●部門別売上高

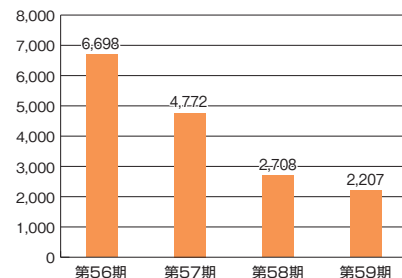
その他
4,067百万円
鉄鋼
2,255百万円
産業機械
4,133百万円
半導体・液晶
4,792百万円



利益指標

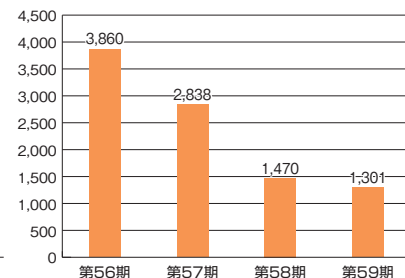
●経常利益

(単位:百万円)



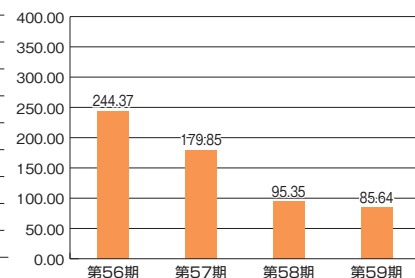
●当期純利益

(単位:百万円)



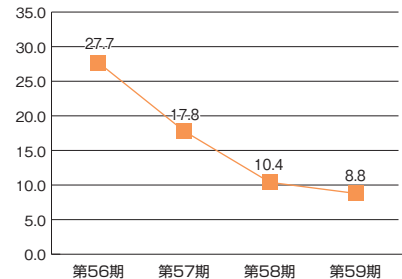
●1株当たり当期純利益

(単位:円)

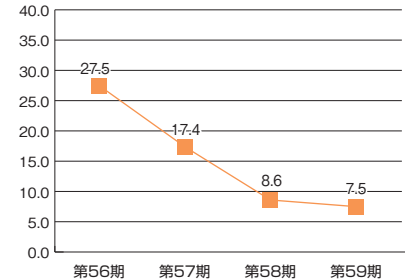


資産指標

●総資産経常利益率 (ROA) (単位:%)



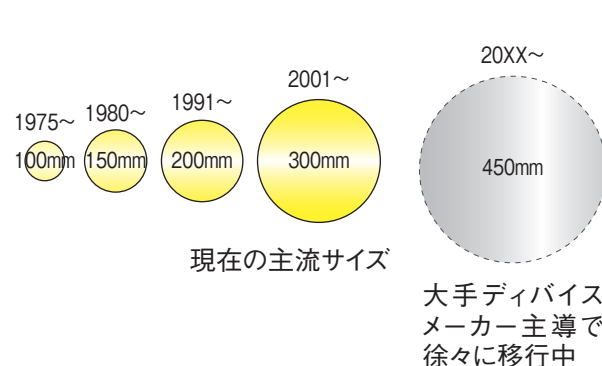
●株主資本利益率 (ROE) (単位:%)



今回は半導体・液晶分野での溶射実施例から、次の3つをご紹介します。

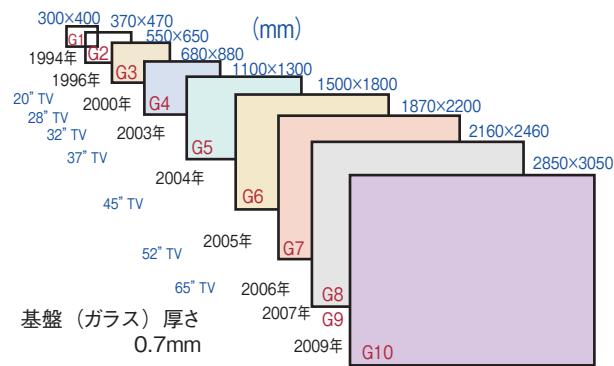
- ① 半導体ウエハー（シリコンウエハー）や液晶ガラス基板を固定するための**静電チャック**
- ② **プラズマエッチング**処理装置のゴミ発生防止と耐久性アップを目的とした表面処理
- ③ **スパッタリング**処理装置の内壁にゴミ落下防止を目的とした表面処理

いずれも溶射法の特性を存分に発揮した独創性に優れたものです。



半導体ウエハーサイズ（直径）の変遷

参考：株式会社SUMCO ホームページ
http://www.sumcosi.com/products/next_generation/large_diameter.html



TFT液晶ディスプレイ用基盤サイズの変遷

参考：旭硝子/AGCグループ ホームページ
http://www.agc-group.com/jp/about/display_01.html

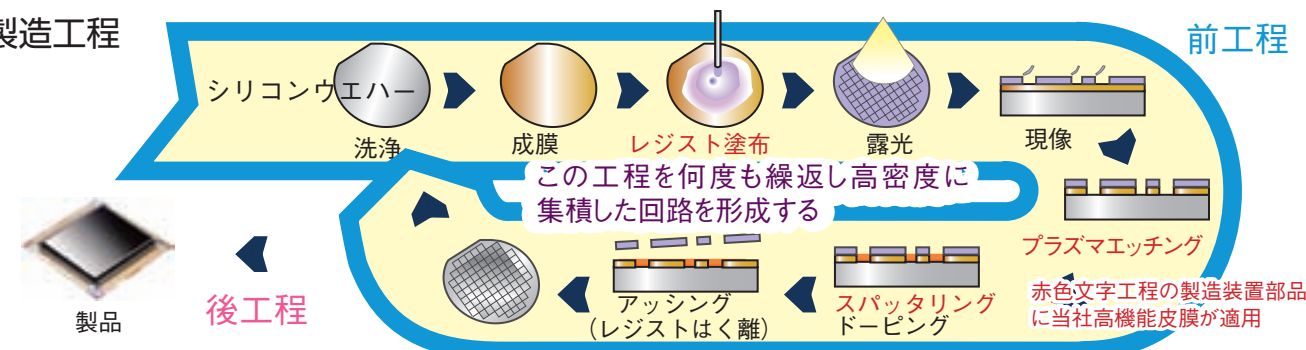
近年、半導体ウエハーやフラットパネルディスプレイの基盤サイズが急激に大型化されました。これは量産効果によるコストダウンを目的としたものですが、特に液晶ディスプレイ用ガラス基板において顕著でした。

これらのトレンドに対応するためには、基盤の大型化に対する様々な対策が必要であり、搬送時のハンドリング設備や溶射設備、工場建屋さえも大型化させる必要が生じました。

また一方では、半導体の高密度集積化やディスプレイの高解像度化も進んでおり、製造装置に求められる要求性能は極めて高度なものになっています。

半導体チップは、スパッタリングやドーピング（成膜）、またはエッチング（除膜）などの工程を幾度も繰り返して複雑な回路を形成します。一つのチップには、数千万～数億個のトランジスターが含まれています。

半導体製造工程



これらの工程は真空雰囲気で行われますが、シリコンウエハーやガラス基盤の固定には非常に高い精度が求められます。現在主流となっているのは静電気によって吸着（固定）させる方式で、強力に均一な静電気を発生させるために吸着盤表面にセラミックス溶射をおこなっています。吸着盤自体は金属製であり静電気を溜めることができません。そこで溶射法でセラミックス皮膜を直接形成します。この吸着盤は固定方式から**静電チャック**（ElectroStatic Chuck; ESC）と呼ばれています。

プラズマエッチングは、反応性プラズマを利用して極微細な溝形状を加工する技術ですが、プラズマは活性に富み装置自身の表面も削ってしまいます。部材自身が削られるということは、高密度集積半導体回路の製造には大敵のゴミを発生することに他なりません。トーカロは、製造装置部材表面に耐プラズマ性に富んだ溶射皮膜を形成し、装置耐久性を高めると共に長時間の連続安定生産を可能にしています。

スパッタリングは、トランジスターを形成するための物質を成膜する工程のひとつです。しかし処理を繰り返すことで成膜物質が真空装置の内壁にも付着し、この付着物が半導体回路に落ちると電気的ショートを起こして不良品となってしまいます。付着物の落下を抑制するため真空装置の内壁に無数の微細突起が出た複雑表面形状の皮膜を溶射法で形成します。内壁付着層は稼働時間と共に厚くなりますが、化学洗浄によって溶射皮膜ごと除去し希少元素を回収するとともに、内壁を再溶射することができます。

スパッタリングは、トランジスターを形成するための物質を成膜する工程のひとつです。しかし処理を繰り返すことで成膜物質が真空装置の内壁にも付着し、この付着物が半導体回路に落ちると電気的ショートを起こして不良品となってしまいます。付着物の落下を抑制するため真空装置の内壁に無数の微細突起が出た複雑表面形状の皮膜を溶射法で形成します。内壁付着層は稼働時間と共に厚くなりますが、化学洗浄によって溶射皮膜ごと除去し希少元素を回収するとともに、内壁を再溶射することができます。

スパッタリングは、トランジスターを形成するための物質を成膜する工程のひとつです。しかし処理を繰り返すことで成膜物質が真空装置の内壁にも付着し、この付着物が半導体回路に落ちると電気的ショートを起こして不良品となってしまいます。付着物の落下を抑制するため真空装置の内壁に無数の微細突起が出た複雑表面形状の皮膜を溶射法で形成します。内壁付着層は稼働時間と共に厚くなりますが、化学洗浄によって溶射皮膜ごと除去し希少元素を回収するとともに、内壁を再溶射することができます。

最小加工線幅の変遷

年 代	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
DRAMの回路幅		180nm	130nm	90nm		60nm	40nm	30nm	
ビット数（容量）		256Mb	512Mb	1Gb		6Gb	16Gb	48Gb	
MPUの電極幅	120nm	90nm	65nm		40nm	30nm	20nm		

トーカロの表面改質技術はこのような部分に貢献しています

コンタミネーション（汚染）防止：半導体チップの高性能・高密度化、製品歩留り向上に寄与
 スループットの増加：半導体チップの生産性向上、メンテナンス費の削減を通じて生産コスト低減に寄与
 優れた機能を装置表面に付与：表面改質技術による製造装置の技術革新に貢献

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	当 期 (平成22年3月31日現在)	前 期 (平成21年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産	12,632	12,498
現金及び預金	4,597	4,077
受取手形及び売掛金	6,584	6,785
仕掛品	336	276
原材料及び貯蔵品	588	881
繰延税金資産	404	357
その他	126	126
貸倒引当金	△5	△6
固定資産	12,032	13,181
有形固定資産	10,896	11,887
建物及び構築物	4,841	4,558
機械装置及び運搬具	2,423	3,379
土 地	2,952	2,952
リース資産	473	428
建設仮勘定	84	403
その他	120	164
無形固定資産	364	423
のれん	—	49
その他	364	374
投資その他の資産	771	870
投資有価証券	295	263
関係会社出資金	302	302
繰延税金資産	62	100
その他	111	204
貸倒引当金	△1	—
資産合計	24,664	25,679

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

POINT 1 資産総額の減少

原材料及び貯蔵品の購入や設備投資を抑えたことおよび既存設備の償却が進んだことにより資産が減少いたしました。

科 目	当 期 (平成22年3月31日現在)	前 期 (平成21年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債	4,764	5,907
支払手形及び買掛金	1,964	2,293
短期借入金	—	400
1年以内返済予定長期借入金	682	626
リース債務	135	101
未払金	121	472
未払費用	948	957
未払法人税等	271	234
賞与引当金	551	546
その他	88	274
固定負債	2,043	2,716
長期借入金	600	1,282
リース債務	363	349
繰延税金負債	108	—
退職給付引当金	920	1,037
その他	50	48
負債合計	6,807	8,624
(純資産の部)		
株主資本	17,854	17,085
資本金	2,658	2,658
資本剰余金	2,293	2,293
利益剰余金	13,675	12,905
自己株式	△772	△772
評価・換算差額等	2	△29
その他有価証券評価差額金	2	△29
純資産合計	17,857	17,055
負債及び純資産合計	24,664	25,679

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

POINT 2 負債総額の減少

借入金の返済および設備投資の減少に伴う未払金の減少により負債が減少いたしました。

POINT 3 純資産の増加

利益増加により利益剰余金が増加いたしました。

連結損益計算書		
(単位:百万円)		
科 目	当 期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日	前 期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日
4 売上高	18,099	22,582
5 売上原価	12,727	16,134
売上総利益	5,372	6,448
5 販売費及び一般管理費	3,342	3,809
営業利益	2,029	2,638
営業外収益	220	114
営業外費用	41	44
経常利益	2,207	2,708
特別利益	23	2
特別損失	41	153
税金等調整前当期純利益	2,190	2,557
法人税、住民税及び事業税	800	1,108
法人税等調整額	88	△21
6 当期純利益	1,301	1,470

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

POINT 4 売上高の減少

半導体・液晶業界他年度前半の需要落ち込みの影響が大きく売上高が減少いたしました。

POINT 5 売上原価および販売費及び一般管理費の減少

各部門での労務費や経費節減努力により費用を減少させることが出来ました。

POINT 6 当期純利益の微減

44億83百万円の売上高減少でありましたが経費節減努力により、当期純利益は1億68百万円の微減に抑えることが出来ました。

連結キャッシュ・フロー計算書		
(単位:百万円)		
科 目	当 期 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日	前 期 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,226	4,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,018	△1,623
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,687	△1,007
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額	519	1,537
現金及び現金同等物の期首残高	4,077	2,539
現金及び現金同等物の期末残高	4,597	4,077

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日							
	株主資本					評価・換算差額等	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	
平成21年3月31日残高	2,658	2,293	12,905	△772	17,085	△29	17,055
当 期 中 の 変 動 額							
剰 余 金 の 配 当			△531		△531		△531
当 期 純 利 益			1,301		1,301		1,301
株主資本以外の項目の 当期中の変動額（純額）						32	32
当 期 中 の 変 動 額 合 計	—	—	769	—	769	32	802
平成22年3月31日残高	2,658	2,293	13,675	△772	17,854	2	17,857

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

会社概要

社 名	トーカロ株式会社 TOCALO Co.,Ltd.
設 立	昭和26年7月
所在地（本社）	〒658-0013 神戸市東灘区深江北町四丁目13番4号
資本金	26億5,882万3千円
従業員数	単独496名 連結573名
■連結子会社	日本コーティングセンター株式会社（JCC） 〒228-0002 神奈川県座間市小松原一丁目43番34号

役 員

地 位	氏 名	担当または主な職業
代表取締役社長	町垣 和夫	
常 務 取 締 役	竹澤 進	営 業 本 部 長
常 務 取 締 役	岡 隆	製造本部長兼環境室長
常 務 取 締 役	谷 和美	溶射技術開発研究所長
取 締 役	木村 一郎	管理本部長兼経営企画室長
取 締 役	三船 法行	製造副本部長
取 締 役	北秋 廣幸	営業副本部長、東華隆（広州）表面改質技術有限公司董事長
取 締 役	樽見 哲男	管理副本部長兼総務部長
取 締 役	久野 博史	明石工場長
取 締 役	坂恵 昌弘	弁護士
常任監査役（常勤）	中井 康亘	
監 査 役（常勤）	藤田 健三	
監 査 役	日下 敏彦	税理士法人日下事務所代表社員
監 査 役	四井 賢一	税理士

（注）1.取締役坂恵昌弘氏は、会社法に基づく社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。
2.監査役中井康亘氏、日下敏彦氏、四井賢一氏は会社法に基づく社外監査役であり、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。

事業所一覧



株式の概況

発行可能株式総数	40,960,000株
発行済株式の総数	15,800,000株 （内、自己株式600,819株）
株主数	5,614名

株主名	持株数（千株）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	1,477
トーカロ従業員持株会	836
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	755
中平 晃	725
廣瀬 真理子	434
資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口）	335
ノーザン トラスト カンパニー（エイブイエフシー） サブ アカウント アメリカン クライアント	295
西條 久美子	259
中平 怜	258
NCT信託銀行株式会社（投信口）	240

